



少量生産・試作・実験用

超小型オールインワンはんだ付け装置
Ultra-small all-in-one soldering machine

SSF-200-B3



SSF-200-B3

多目的

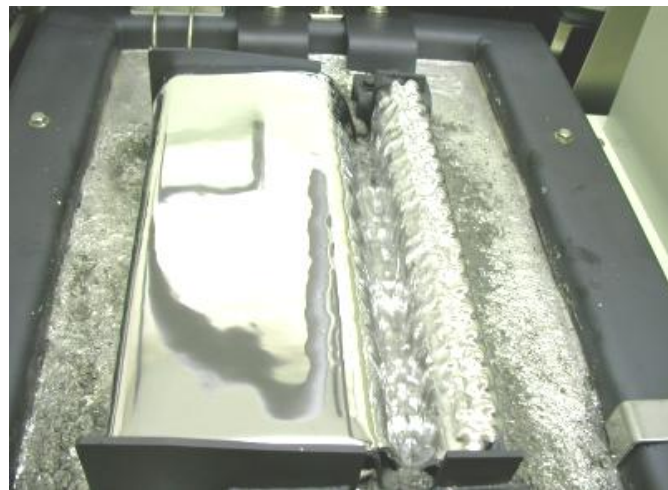
省スペース

オールインワン

1

2

3



① 多目的な少量生産に

開発・試作用

研究室などにも設置可能な省スペース設計です。

数値管理で基板にあわせた最適条件や試作における細かい条件設定が可能です。

少量生産・セル生産ライン用

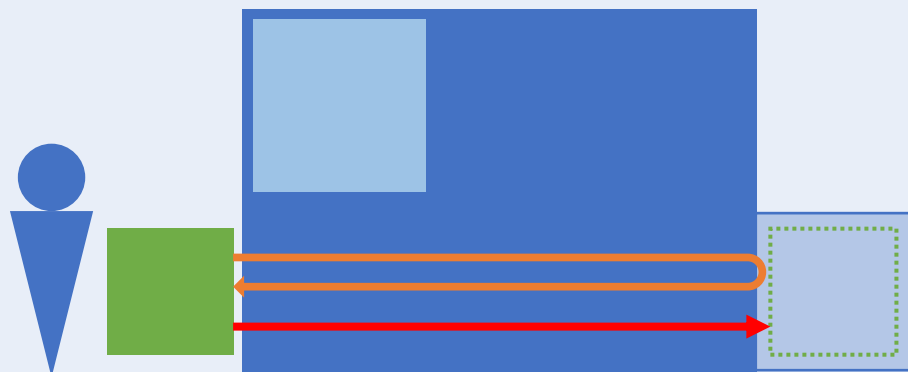
小型基板でチップ部品のはんだ付けが必要な場合や、稼働が少ないはんだ槽の代替えとして最適です。

また、DIPパレットを使用することで後付け部分のはんだ付けが可能です。

簡単にレイアウトが可能であるため、専用のセル生産ラインを構築することができます。

用途にあわせた搬送

搬送は、フロアのレイアウトや作業工程にあわせて、**リターンバック**と**スルー**搬送を切り替えることができます。



リターンバック：

冷却後、作業者の手元に戻ります。

スルー：

冷却後、冷却ゾーンでワークを離脱します。

② 小型・省スペース

SSF-200-B3は、小型でありながら装置内にはんだ付けに必要な要素(フラクサー・プリヒーター・はんだ槽・冷却)をすべて備えているため、占有面積を押さえることができます。

稼働することが少なくなったはんだ槽と入れ替えることで、限られらスペースを有効に活用することが可能です。

下記のイメージ図では、占有面積(扉の開閉等で必要な余剰の面積を考慮しない)を80%以上削減できる想定です。



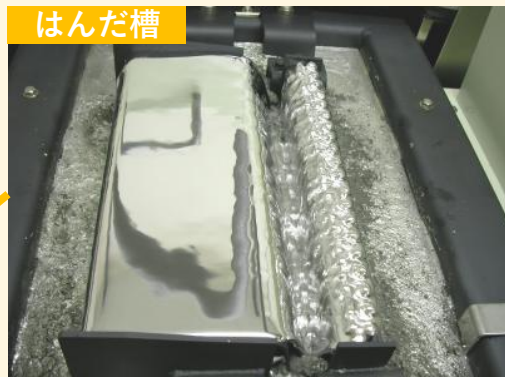
3 オールインワンのはんだ槽

SSF-200-B3は、フラクサー、予熱、はんだ槽、冷却を一体化したオールインワン構成です。
省スペースでセル生産を実現できるため、少量生産や、稼働率が低下したフロー槽の置き換えに最適です。

冷却



はんだ槽



スプレー



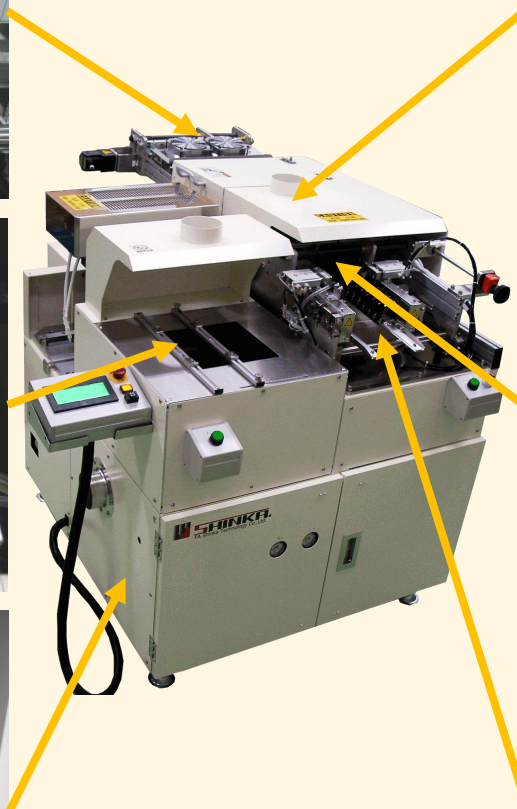
プリヒータ



フラックスタンク



搬送機

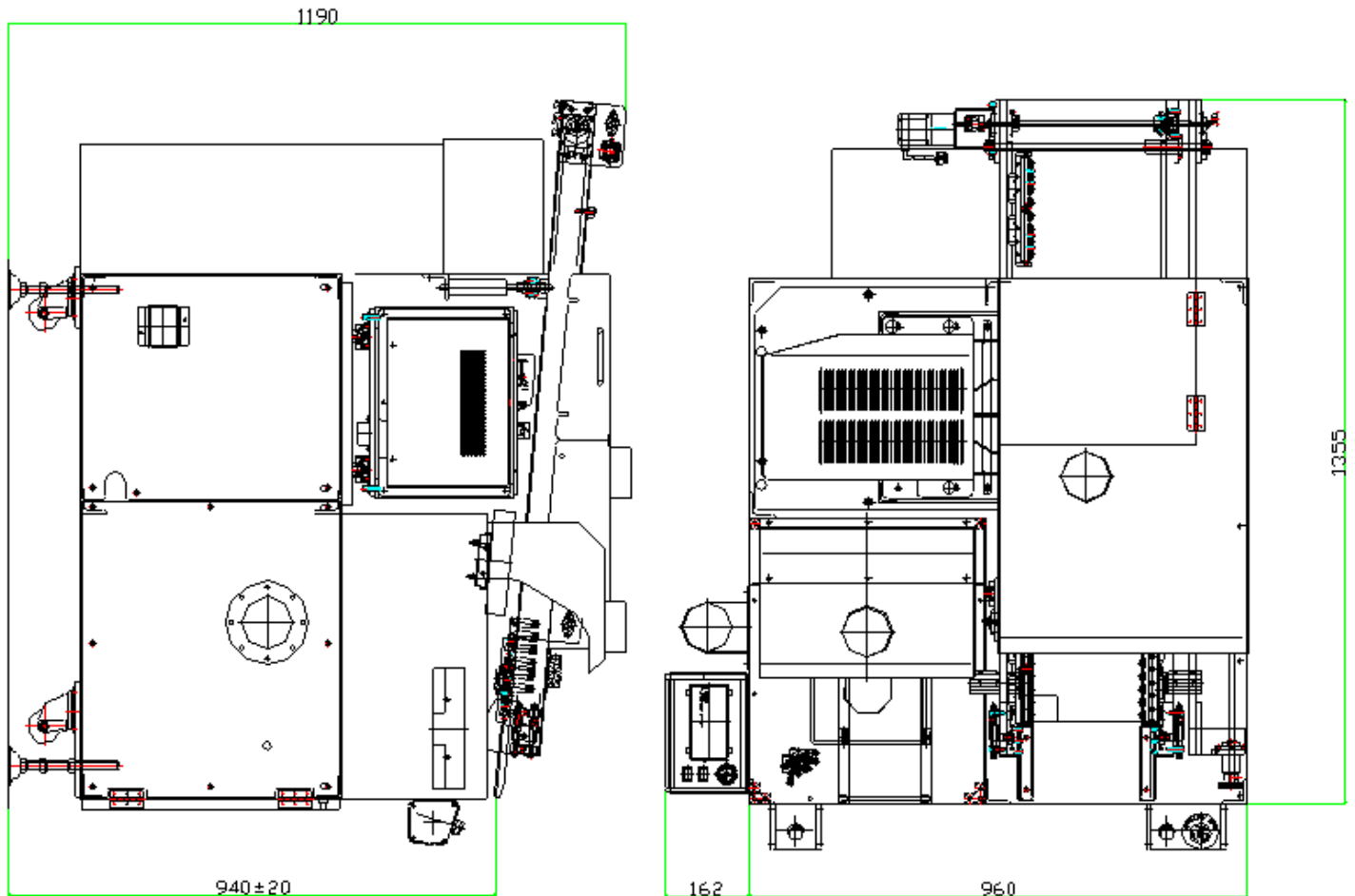


その他

噴流ノズルが非常にコンパクトなため、メンテナンス時の取り扱いが容易です。
また、小型はんだ槽であることから必要なはんだ量が少なく、コストを抑えることができます。



外観図



外形寸法・装置重量	960(W) × 1,355(D) × 1,190(H)mm / 約350kgf
ワークサイズ	外形：50(W) × 50(D)～210(W) × 230(D)mm 厚さ：0.8～2.3mm 部品高さ制限：基板下6mm/上50mm
スプレーフラクサー	XYロボット式 / 低圧スプレー×1 / 最大100cc/sec
プリヒータ	下面IR(遠赤外線)パネルヒータ / 1kW
はんだ槽	SUS316L(窒化处理) / 容量約170kgf(比重7.4として)
搬送	搬送方式：基板チャック搬送 搬送角度：5°C 幅変更方法：手動ハンドル
冷却	上下クロスフローファン
ユーティリティ	電源：3相200V / 50A エアー：0.5MPa・120NL/min(ドライエアー) ダクト：φ100×天面2か所、側面1か所(有機排気および熱排気)